



Final Product/Process Change Notification

Document #: FPCN22945X

Issue Date: 01 Jun 2020

Title of Change:	Qualification of TSOP6 Epoxy NTGS3446T1G Device from 2.0 mils Au to 2.0 mils Cu Wire.	
Proposed First Ship date:	08 Sep 2020 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or AnneLee.Lim@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or MohdAzizi.Azman@onsemi.com	
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected products will be identified with date code after WW37'20 onwards	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	None	
Description and Purpose:		
This Product Change Notification is to announce that ON Semiconductor Seremban is qualifying TSOP6 Epoxy NTGS3443T1G Device from 2.0 mils Au to 2.0 mils Cu Wire.		
	Before Change Description	After Change Description
Bond Wire	2.0mil Heraeus Gold Wire	2.0mil Tatsuta TC-A Bare Cu Wire
There is no product marking change as a result of this change.		

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME: NTGS3446T1G

RMS# : S62433

PACKAGE : TSOP 6

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22945X

発行日: 01 Jun 2020

変更件名:	TSOP6 樹脂 NTGS3446T1G 製品における 2.0 mils 金ワイヤーから 2.0 mils 銅ワイヤーへの変更認定	
初回出荷予定日:	08 Sep 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または AnneLee.Lim@onsemi.com にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.samples@onsemi.com にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または MohdAzizi.Azman@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。 お問い合わせは PCN.Support@onsemi.com 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける製品は、WW37'20 以降の日付コードで識別されます。	
変更カテゴリ: アセンブリの変更		
変更サブカテゴリ: 材料の変更		
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Seremban, Malaysia	無し	
説明および目的:		
この製品変更通知は TSOP6 樹脂 NTGS3446T1G 製品において 2.0 mils 金ワイヤーから 2.0 mils 銅ワイヤーへの変更認定をお知らせいたします。		
	変更前の表記	変更後の表記
ボンドワイヤー	2.0mil Heraeus Gold Wire	2.0mil Tatsuta TC-A Bare Cu Wire
今回の変更に伴う製品マーキングの変更はありません。		



信頼性データの要約:

デバイス名 : NTGS3446T1G

RMS : S62433

パッケージ : TSOP 6

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/231
HTGB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	15000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
H3TRB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	2016 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C		0/924
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/90

電気的特性の要約:

電気的特性は影響を受けません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NTGS3446T1G	NTGS3446T1G